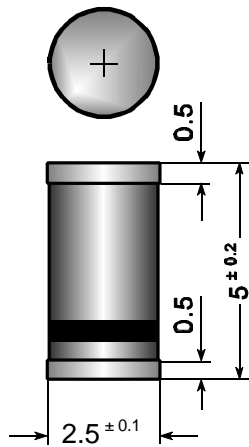


**Ultrafast Surface Mount
Silicon Rectifiers**
**Ultraschnelle Si-Gleichrichter
für die Oberflächenmontage**


Dimension / Maße in mm

Nominal current – Nennstrom	1 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzenspernung	50...1000 V
Plastic case MELF Kunststoffgehäuse MELF	DO-213AB
Weight approx. – Gewicht ca.	0.12 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform getupet auf Rolle	see page 18 siehe Seite 18

Maximum ratings
Grenzwerte

Type Typ	Rep. peak reverse voltage Period. Spitzenspernung	Surge peak reverse voltage Stoßspitzenspernung	Reverse recovery time *) Sperrverzugszeit *)
	V_{RRM} [V]	V_{RSM} [V]	t_{rr} [ns]
SUF 4001	50	50	< 50
SUF 4002	100	100	< 50
SUF 4003	200	200	< 50
SUF 4004	400	400	< 50
SUF 4005	600	600	< 75
SUF 4006	800	800	< 75
SUF 4007	1000	1000	< 75

 *) $I_F = 0.5$ A through/über $I_R = 1$ A to/auf $I_R = 0.25$ A

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last	$T_A = 50^\circ\text{C}$	I_{FAV}	1 A ¹⁾
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15$ Hz	I_{FRM}	10 A ¹⁾
Rating for fusing, $t < 10$ ms Grenzlastintegral, $t < 10$ ms	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	3,6 A ² s
Peak fwd. half sine-wave surge current Stoßstrom für eine Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$f = 60$ Hz $f = 50$ Hz	I_{FSM} I_{FSM} 30 A 27 A

¹⁾ Valid, if mounted on P.C. board with 60 mm² copper pads at each terminal

 Dieser Wert gilt bei Montage auf Leiterplatte mit 60 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß

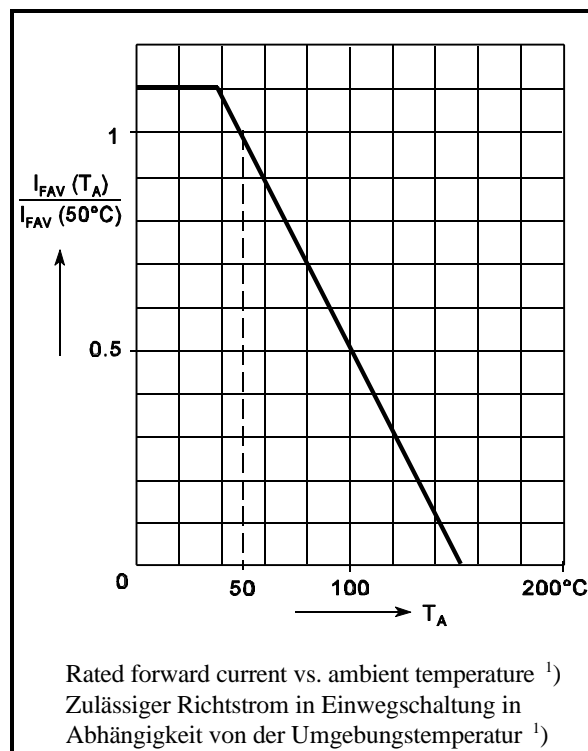
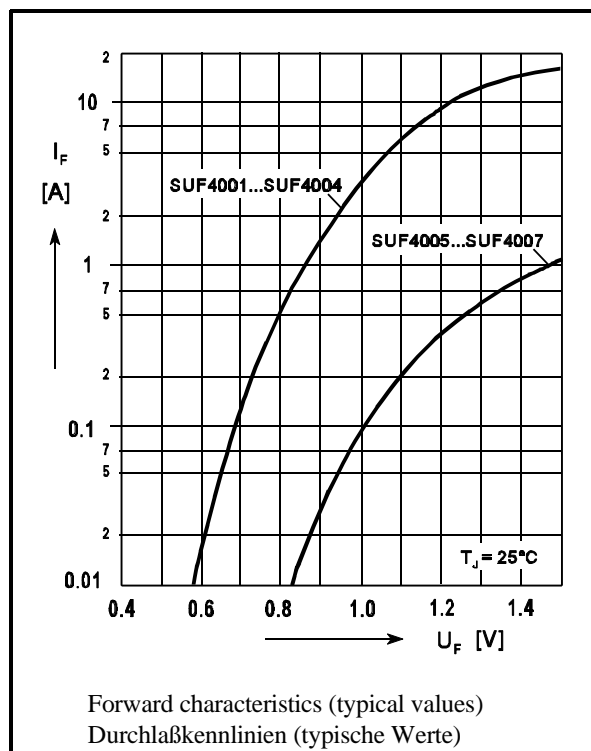
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
 Storage temperature – Lagerungstemperatur

T_j – 50...+150°C
 T_s – 50...+175°C

Characteristics

Kennwerte

Forward voltage	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 1\text{ A}$	SUF 4001...SUF 4004	U_F	< 1.0 V
Durchlaßspannung			SUF 4005...SUF 4007	U_F	< 1.7 V
Leakage current	$T_j = 25^\circ\text{C}$		$V_R = V_{RRM}$	I_R	< 10 μA
Sperrstrom	$T_j = 100^\circ\text{C}$		$V_R = V_{RRM}$	I_R	< 50 μA
Thermal resistance junction to ambient air				R_{thA}	< 45 K/W ¹⁾
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft					



¹⁾ Valid, if mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal
 Dieser Wert gilt bei Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluß